

平成 23 年 10 月 28 日

各 位

会 社 名 テクノクォーツ株式会社
 代 表 者 取締役社長 岡本克己
 (JASDAQ コード番号 5217)
 問 い 合 せ 先 取 締 役 小 野 文 男
 管 理 本 部 長
 (TEL03-5354-8171)
 当 社 の 親 会 社 ジーエルサイエンス株式会社
 代 表 者 取締役社長 外丸勝彦
 (東証第2部 コード番号 7705)

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 23 年 5 月 11 日に公表いたしました業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期連結累計期間 連結業績予想数値の修正

(平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 9 月 30 日)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
前回発表予想(A)	2,348	32	9	3	0円46銭
今回修正予想(B)	2,535	326	303	286	37円05銭
増減額(B-A)	186	294	293	283	
増減率(%)	7.9	908.0	—	—	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成 23 年 3 月期第 2 四半期)	2,417	177	147	139	17円98銭

2. 平成 24 年 3 月期第 2 四半期累計期間 個別業績予想数値の修正

(平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 9 月 30 日)

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
前回発表予想(A)	2,348	29	7	2	0円35銭
今回修正予想(B)	2,511	234	209	204	26円37銭
増減額(B-A)	162	204	201	201	
増減率(%)	6.9	692.6	—	—	
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成 23 年 3 月期第 2 四半期)	2,399	136	117	111	14円34銭

3. 修正の理由(連結・個別)

半導体市場は新興国における需要拡大等により堅調に推移し、半導体製造装置内の消耗品を製造・販売する当社グループは豊富な受注残を抱え、第1四半期(4月～6月)の売上高は計画を上回って推移し、また、原価低減や経費削減にも努めたことから、利益は大幅に増加しました。

7月以降は、世界的な景気後退懸念から半導体の需給ギャップが拡がり、一転して受注、売上高はともに減少に転じましたが、第2四半期(累計)時点での影響は限定的であったことから、平成 23 年 5 月 11 日に公表しました予想数値を上記のとおり、上回る見通しであります。

なお、通期見通しにつきましては、主要顧客の投資抑制の影響が大きく、10月以降の受注見通しが不透明なことから、5月11日公表の予想数値を据置いております。

(注)上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以 上